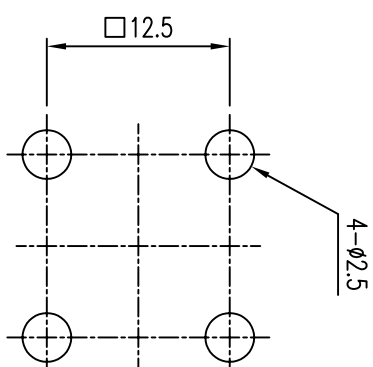
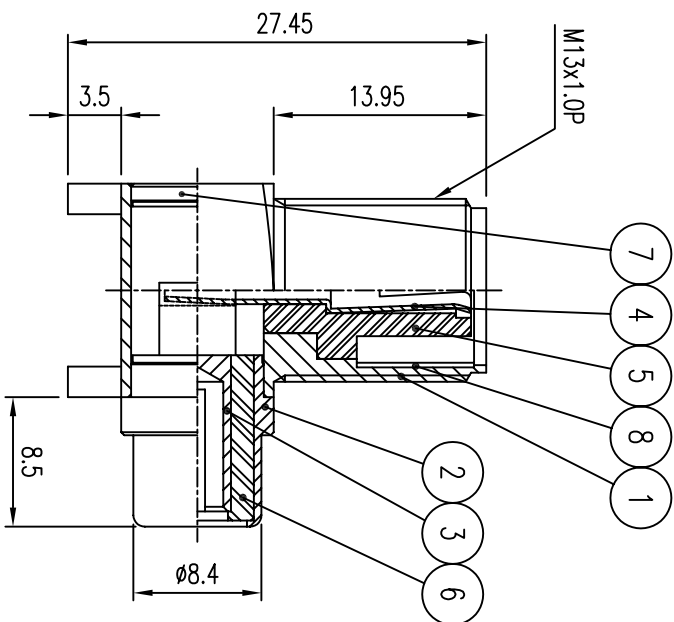
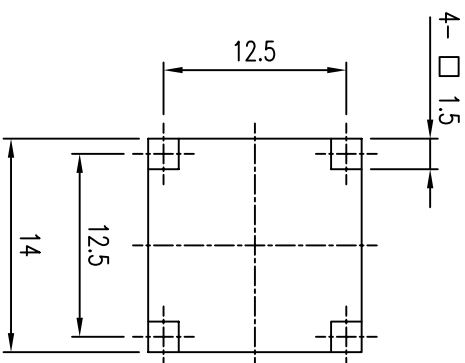


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	부호	내 용	수 정 내 용	년 월 일
기공	CNC	비동산면	후기공							1	내 용	수정지	승인지
ST(기초)										2	PN 불림방지	손문호	안병호
ST(제1차)										2	INSULATOR:PN 금형으로 변경	손문호	김기영
													2004. 4. 12.
													2004. 10. 4.



PCB HOLE



8	SPRING RING	1	PBR	Nickel Plate	DSR00030-5/1 (RA005)
7	COVER	1	NBSBD	Sn Plate	DCO00052-5/1 (LA008)
6	INSULATOR	1	TEHLON		DN01030-N/1 (HA185)
5	INSULATOR	1	ACETAL MOLD	WHITE	DN01032-N/1 (HA200)
4	CONTACT	1	PBS t=0.3	Silver Plate	DCT00819-5/1 (EA216)
3	CONTACT	1	NBSBD	Silver Plate	DCT01099-5/1 (EA189)
2	BODY(B)	1	NBSBD	Sn Plate	DBD01656-5/1 (DA2168)
1	BODY(A)	1	NBSBD	Sn Plate	DBD01127-5/1 (DA217)

적용업체		년월일		제품명		도면	
삼성전자		2004. 2. 24.		KJ COMTECH CO.,LTD.		IR & MICROLINE TECHNOLOGY	
업체코드		승인		KJ COMTECH CO.,LTD.		Tel : 82-25-342-8015	
3705-001328		감도		도면		Fax : 82-25-342-8017	
제질		체도		A4		AD00174-7/1	
열처리		적용부서		도면		K361-992-102	
보호파막처리		작도		NS		단위 mm	
		중량					